



导电性Ni-P微粒子(镍磷)

电路中信号传输

面向更高速度、更大容量的新产品



特长

- 高真球度和均一粒径
- 通过各种电镀实现低电阻化
- Ni-P粒子芯的耐热性、高硬度

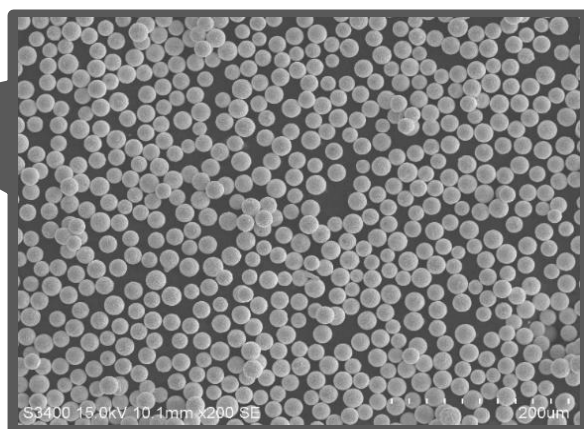
用途

- 芯片2.5G安装部件
- 芯片粘贴胶用间隙材料
- 各向异性导电薄膜用导电粒子

■ 真球度高，表面光滑，单分散，具有均一的粒径尺寸 (1~30 μ m)

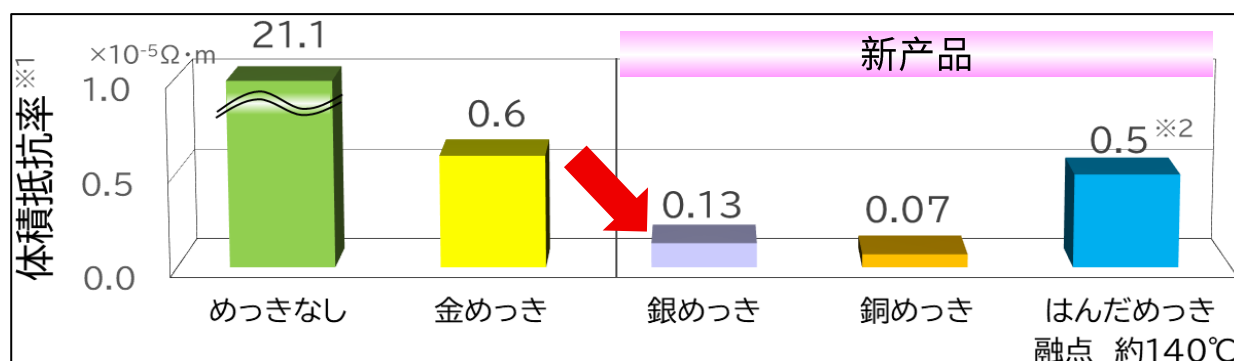


Ni-P微粒子镀件的外观



SEM图像

■ 通过不同电镀赋予“低电阻”、“金属结合”、“耐腐蚀性”等各种功能
不同镀层的Ni-P微粒特性比较



※1体积电阻率根据粒径、电镀膜厚度、焊接状态而变化。

※2焊锡的体积电阻率为焊接前的数值。